

## 請求の範囲

1. 第1の面およびこれと反対の第2の面を有し、当該第2の面は露出部と当該露出部の周りの退避部とを有する、ダイパッドと、

5 前記ダイパッドの前記第1の面に搭載された半導体チップと、

前記露出部を露出させつつ前記退避部に接して前記ダイパッドおよび前記半導体チップを覆う封止樹脂とを備える、半導体装置。

2. 前記退避部は、退避面と、前記露出部に隣接して前記退避面と銳角をなす側

10 面とにより規定されている、請求項1に記載の半導体装置。

3. 前記ダイパッドは、前記第2の面における前記退避面および前記第1の面にて開口するスリットを有する、請求項1に記載の半導体装置。

15 4. 前記ダイパッドは、前記第2の面における前記退避面および前記第1の面にて開口する複数のスリットを有し、当該複数のスリットは、前記半導体チップを囲むように位置する、請求項1に記載の半導体装置。

5. 前記半導体チップおよび前記ダイパッドは、第1ワイヤを介して電気的に接続されており、前記第1ワイヤは、前記ダイパッドの前記第1の面において、前記ダイパッドの周端と前記スリットとの間に接続されている、請求項3に記載の半導体装置。

20 6. 更に、前記半導体チップとは第2ワイヤを介して電気的に接続された端子を備え、当該端子は、一部が露出するように前記封止樹脂に保持されている、請求項1に記載の半導体装置。

7. 半導体チップと、当該半導体チップが搭載される上面とこれとは反対の下面とを有し且つ第1ワイヤを介して前記半導体チップに電気的に接続されたダイパ

ッドと、第2ワイヤを介して前記半導体チップに電気的に接続された複数のリードとを備え、前記ダイパッドの前記下面が露出された状態で前記半導体チップが封止樹脂によって封止された半導体装置であつて、

前記ダイパッドは、当該ダイパッドの周縁に沿って前記下面が切り欠かれる  
5 ことによって形成された薄肉部、および、当該薄肉部を貫通する少なくとも1つのスリットを有する、半導体装置。

8. 前記封止樹脂は、前記少なくとも1つのスリットの開口が露出しないように、  
前記薄肉部の下方に回り込むように設けられている、請求項7に記載の半導体裝  
10 置。

9. 前記少なくとも1つのスリットは、前記半導体チップの側面に沿って当該半  
導体チップを囲むように設けられている、請求項8に記載の半導体装置。

15 10. 前記第1ワイヤは、一端が前記半導体チップに接続され、他端が、前記ダイ  
パッド上における、前記ダイパッドの周端と前記スリットとの間に接続されてい  
る、請求項8に記載の半導体装置。

11. 導体フレームに対して打ち抜き加工を施すことにより、上面とこれと反対の  
20 下面を有するダイパッドを形成するとともに、当該ダイパッドの周縁近傍において前記ダイパッドを貫通するスリットを形成する工程と、

前記ダイパッドの周縁に沿って前記下面に対してエッチングを施すことによ  
り、前記ダイパッドに対して薄肉部を、当該薄肉部にて前記スリットが開口する  
ように、形成する工程と、

25 前記ダイパッドの上面に半導体チップを搭載する工程と、  
前記半導体チップと前記ダイパッドとをワイヤボンディングする工程と、  
前記ダイパッドの下面が露出するように、封止樹脂により半導体チップを封  
止する工程と、を含む、半導体装置の製造方法。